

2026年 法人說明會

總經理 黃道景 2026.3.26

股票代號：3444

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw
代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw
股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw





投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外在風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。

AGENDA

- 01 公司介紹
- 02 2025 營運成果
- 03 2026 營運策略
- 04 營運展望



01

公司介紹

高科技材料整合方案的提供者



1 公司介紹

創 立：1993年

資本額：4.5億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司

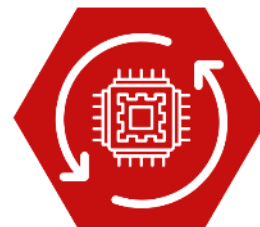


高雄分公司



蘇州分公司

營業項目：



通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、
零件與設備

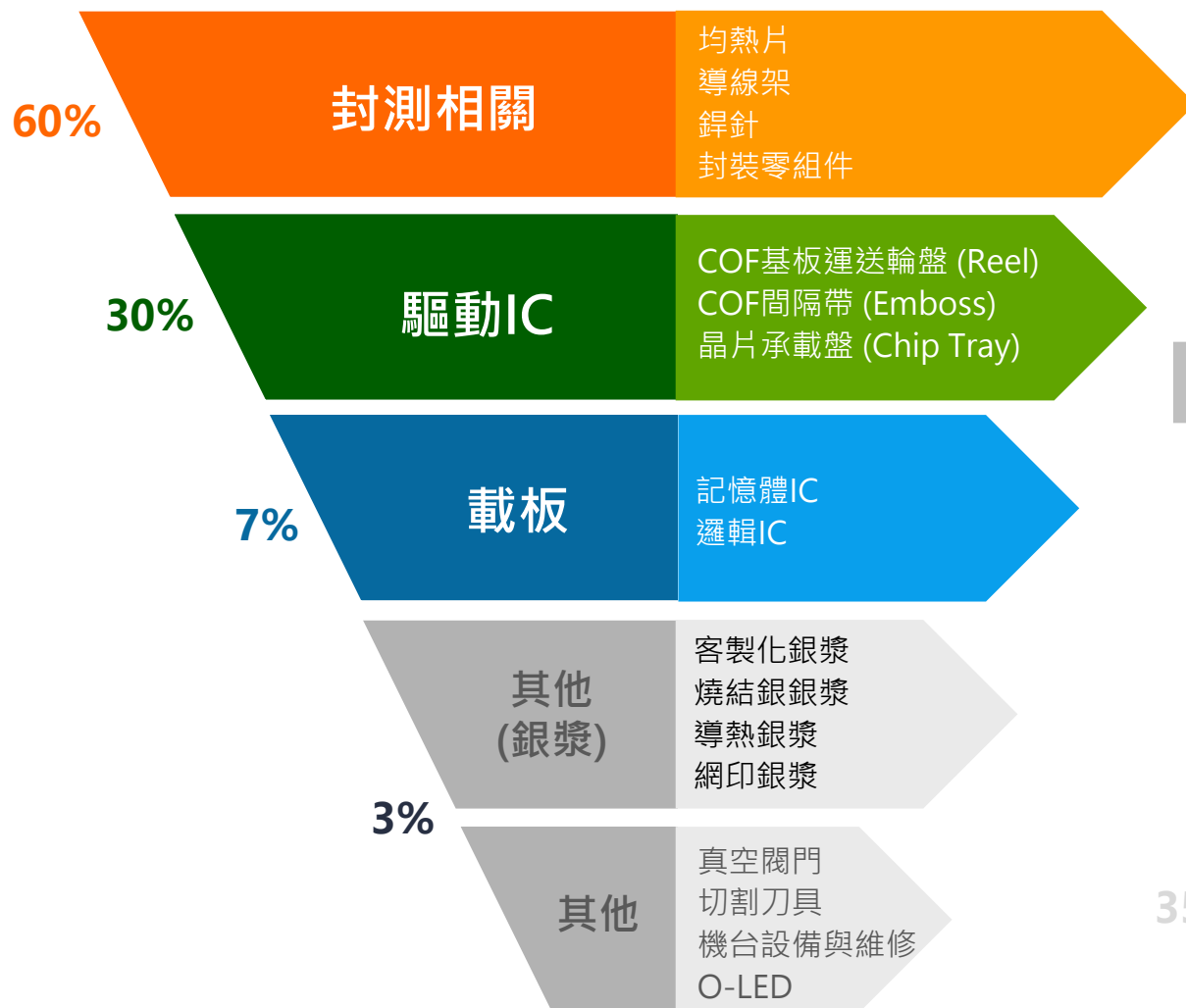


自有研發與製造

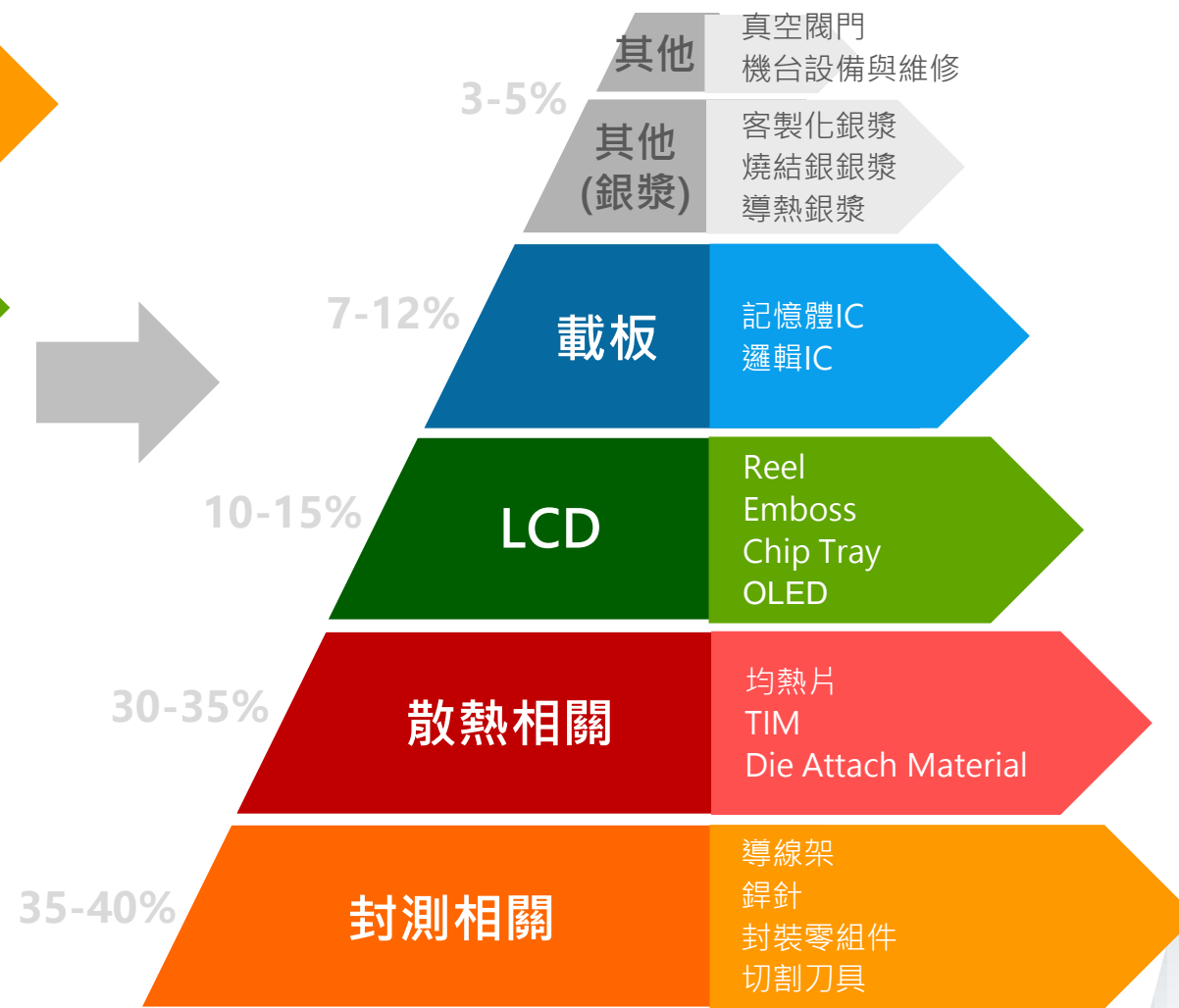
1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿

2 產品分類

2025 (三大主力產品)



2026 (四大主力產品)





02 2025營運成果

全年營收創下近14年歷史新高



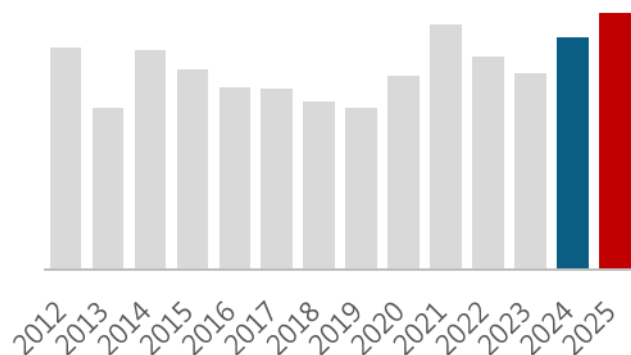
1 2025年營運亮點

主要受惠AI伺服器與高效能運算 (HPC) 散熱需求強勁，封測產品帶動整體營收

12.75 億

全年合併營收 (NTD)

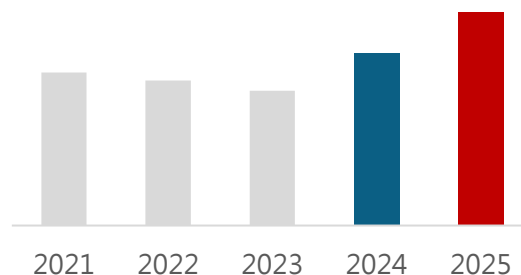
YoY 11%
創近14年新高



30%

封測材料營收年增率

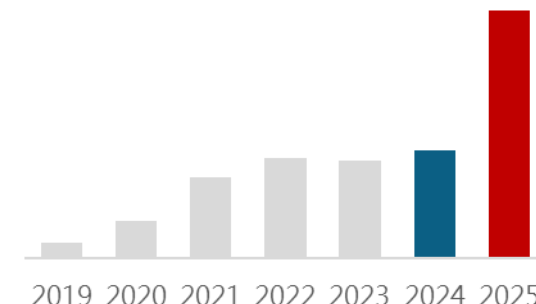
AI/HPC 強勁拉貨



129%

均熱片 (Heat Spreader) 年成長

創產品線新高



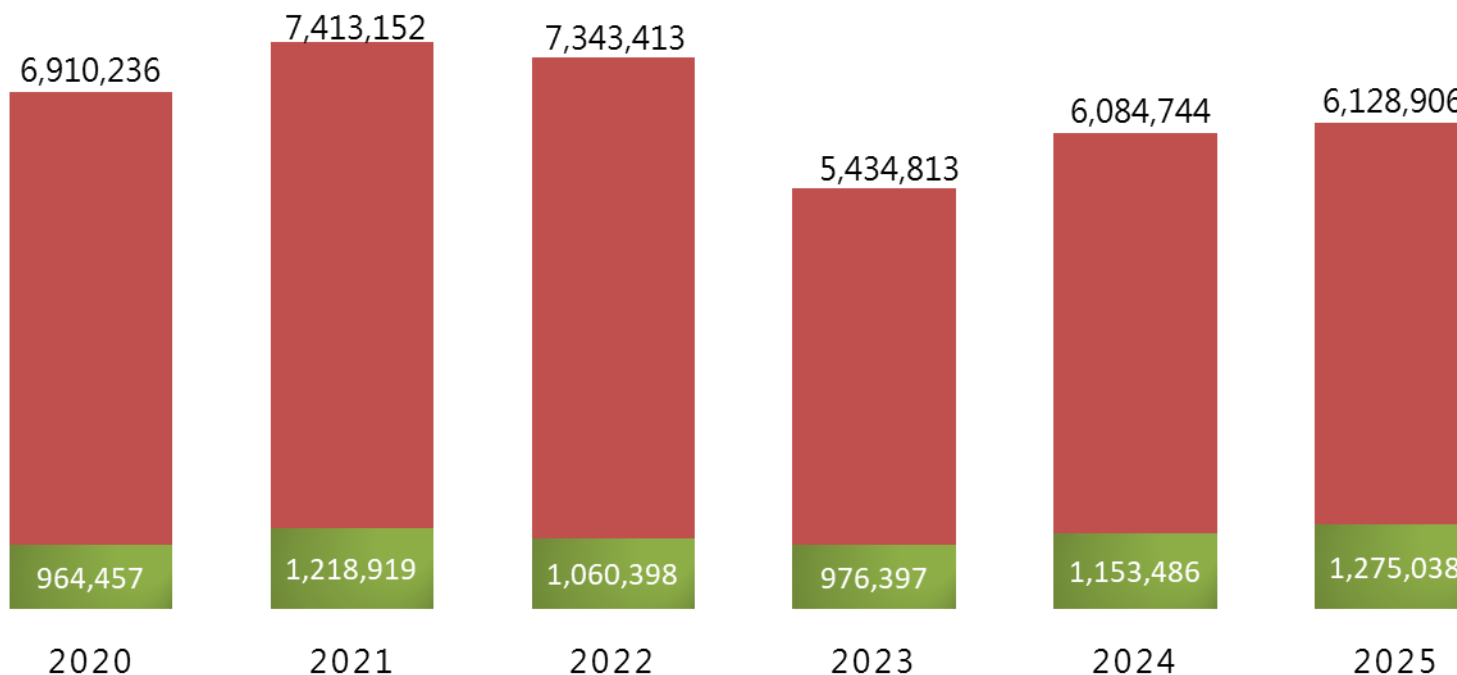
■ 2025 :
■ 營收 YoY=11% ,
■ 接單金額 YoY=0.7%

■ 2013-2025 CAGR :
■ 營收 YoY=3.9%
■ 接單金額 YoY= 7.8%

■ 營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)
■ 接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)

■ 營收 ■ 接單金額

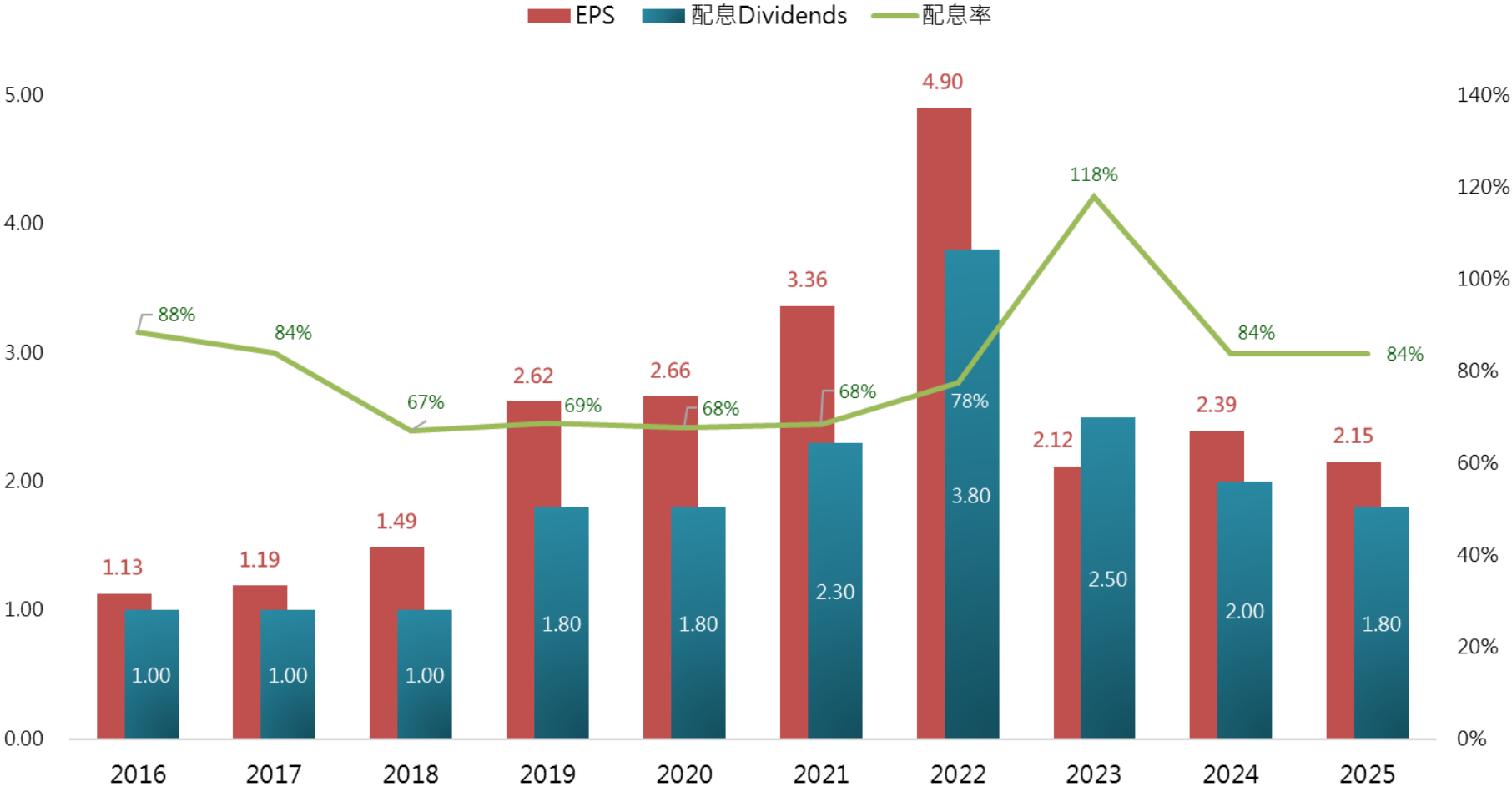
(NT\$Thousand)



(NT\$仟元)	2023	2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	2025	2025年		
								Q4	累計全年	
								QoQ	YoY	YoY
營業收入	976,397	1,153,486	301,151	322,585	306,876	344,426	1,275,038	12%	11%	11%
營業毛利	255,756	284,926	72,596	70,956	61,847	62,332	267,731	1%	-9%	-6%
毛利率	26%	25%	24%	22%	20%	18%	21%	-10%	-19%	-15%
營業淨利	75,279	78,293	22,457	27,255	9,599	15,223	74,534	59%	3%	-5%
營業外收(支)	36,565	65,185	19,679	(12,304)	15,454	13,176	36,005	-15%	-52%	-45%
稅前淨利	111,844	143,478	42,136	14,951	25,053	28,399	110,539	13%	-33%	-23%
本期淨利	93,545	107,452	35,650	18,657	19,346	22,944	96,597	19%	-36%	-10%
淨利率	10%	9%	12%	6%	6%	7%	8%			
EPS (NT\$) 註:	2.12	2.39	0.79	0.41	0.43	0.52	2.15	20%	-36%	-10%

註：係追溯調整後

NT\$仟元	2022	2023	2024	2025
資產				
現金及約當現金	327,431	398,797	333,159	509,696
應收帳款	532,247	443,432	550,367	455,480
存貨	60,048	67,008	60,611	65,653
轉投資相關	257,247	263,434	252,910	129,446
不動產、廠房及設備	226,154	223,341	286,419	289,547
其他資產	26,539	34,288	29,040	48,811
資產總計	1,429,666	1,430,300	1,512,506	1,498,633
負債				
短期借款	150,000	-	-	-
應付帳款	227,968	233,559	315,611	345,767
其他負債	131,435	110,272	122,610	73,780
負債總計	509,403	343,831	438,221	419,547
權益總計	920,263	1,086,469	1,074,285	1,079,086
淨值 (NT\$元 /股)	23.53	24.63	23.87	23.98



03

2026營運策略

G.R.O.W 多重引擎成長 (multi-engine growth)





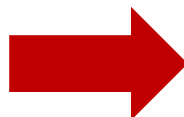
策略轉型 (~2025)

2005~2018

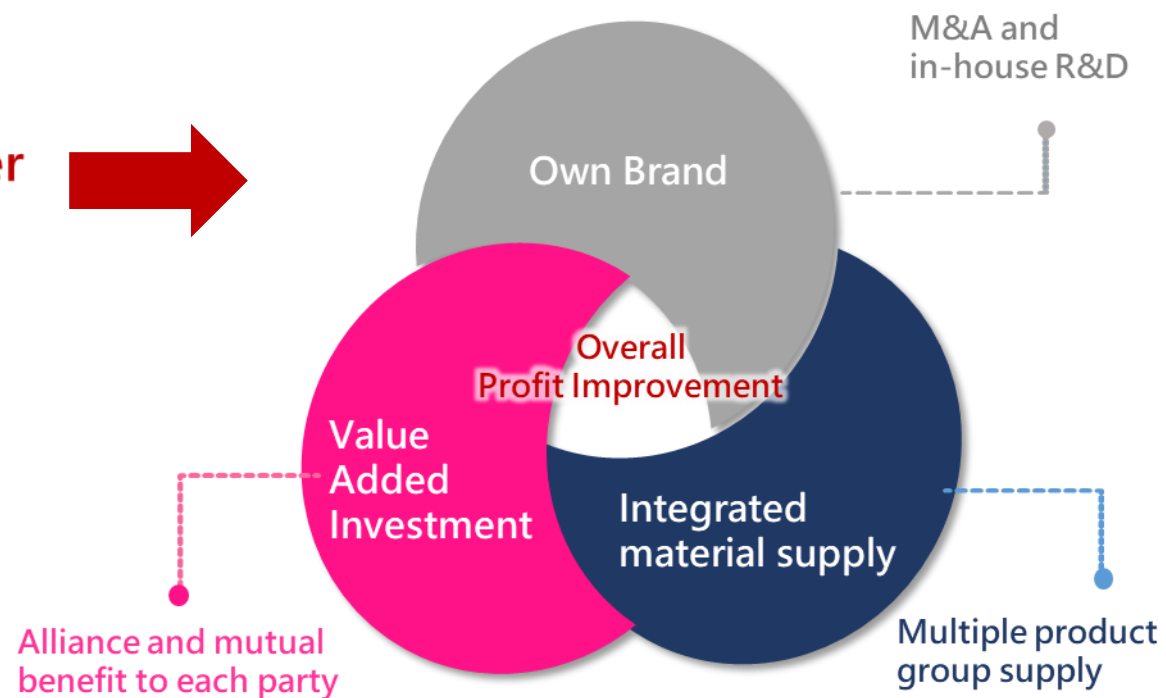
Agent



Integrated Material Solutions Provider



2019-2025





2026營運策略



1 Grow Through M&A

- 垂直整合: 併購 散熱材料廠 與 電鍍廠
- 水平整合: 併購 其他產品線 與 代理商



2> Reach New Markets with New Products

Promotion Phase

Under Qualification

Sales Ramp Up

1. Wafer inspection equipment

1st step – Equipment maintenance

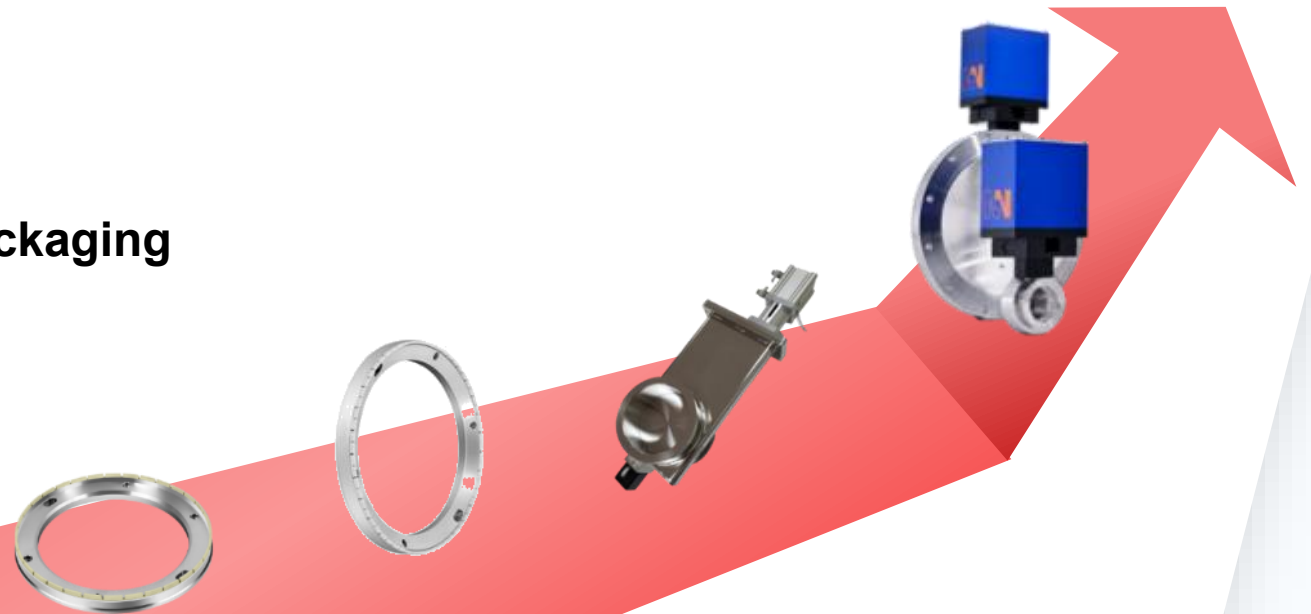
2nd step – Equipment selling

2. Wafer & IC testing – Probe card, BIB

3. Slurry of wafer grinding for advanced packaging

• 晶圓切割相關

• 真空閥門

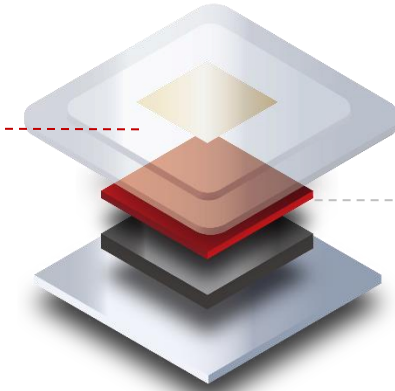


3 > Outperform with Thermal Solutions

封裝導熱
total
solution
provider

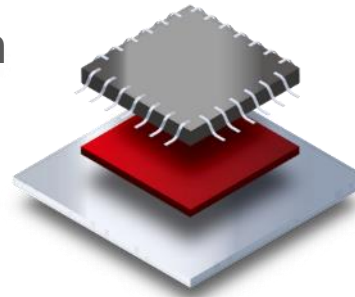
1 Heat Spreader

2 Ultra High Thermal Materials

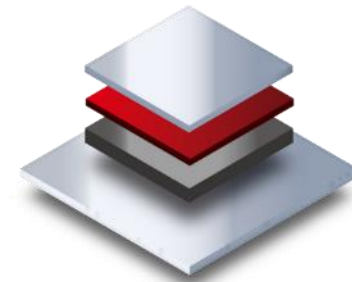


TIM1

Die Attach



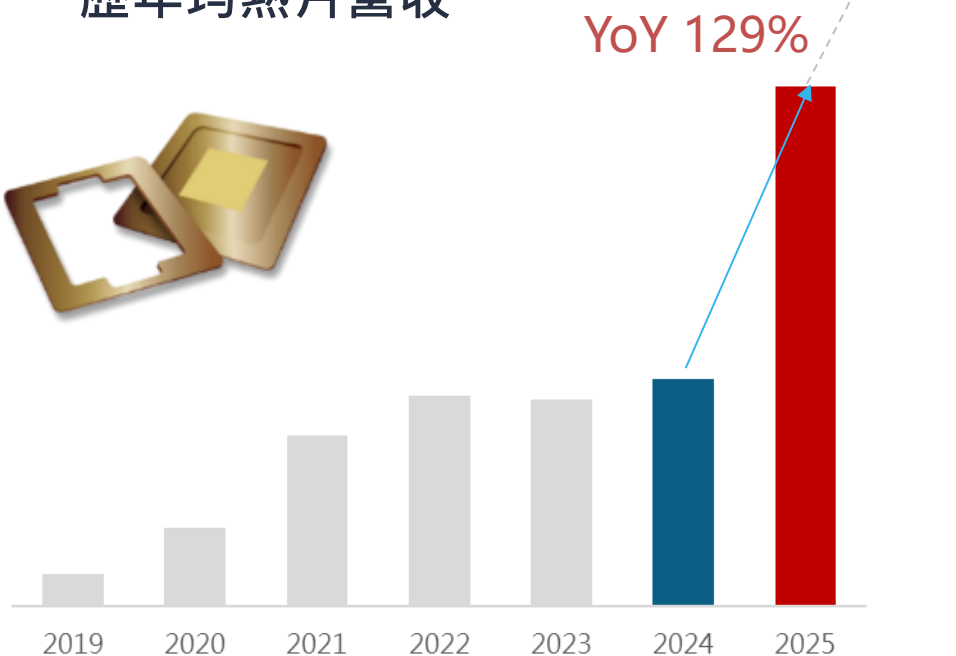
TIM1



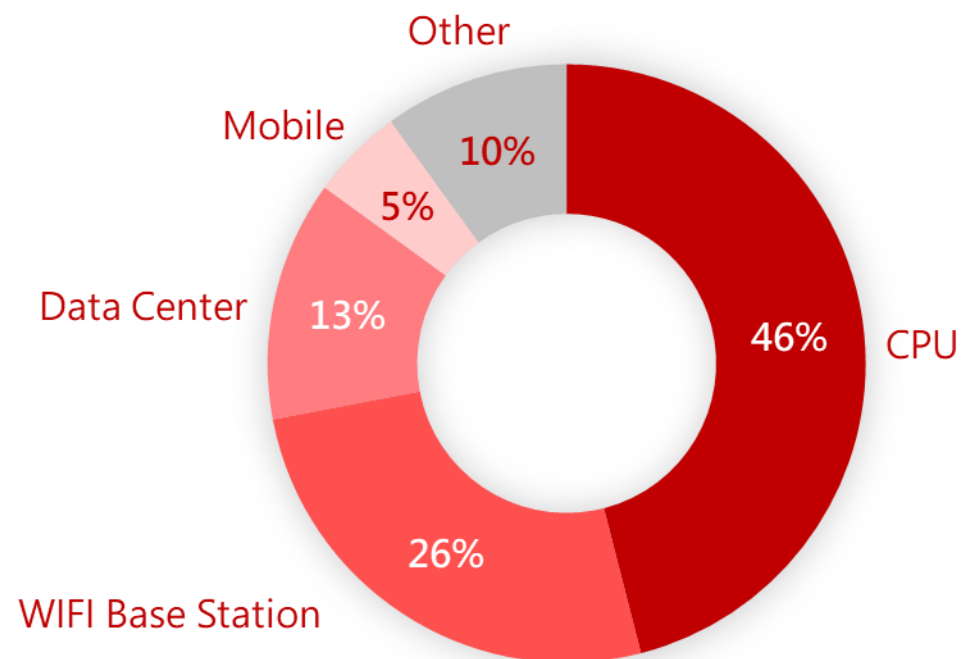
3> Outperform with Thermal Solutions

1 Heat Spreader

歷年均熱片營收



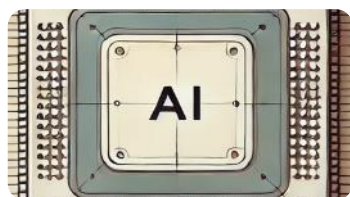
各領域應用營收占比



3 > Outperform with Thermal Solutions

2 Ultra High Thermal Materials

HPC



- CPU
- GPU
- ASIC

TIM1

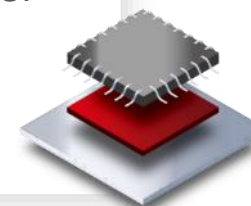


RF Amp Device



Die Attach

- Power Amplifier
 - GaAs
 - GaN



High Power LED



- Backlight
- Special Lighting
- Sensor

Die Attach

Power Device



Die Attach

- Module Assembly
- MOSFET/Driver
- GaN & SiC

4

Win with Advanced Materials Technology



TIM 1

TIM 2

Die Attach Material

階段性建置 銀/銅 與 有壓/無壓 的產品矩陣，
提升客戶製程相容性，建立全方位解決方案



材料

製程

Ag (性能佳)**Cu** (成本低)**Pressure-less**
(產線整合容易)

- Power Device
- RF PA
- LED/Sensor
- Low Power

- Power Device
- RF PA

**Pressure**
(導熱更穩 可靠度佳)**NEW**

- Module Assembly
(電動車用逆變器)

- Power Device



04

營運展望

產品結構優化，展現成長韌性





營運展望

- 2026年積極實踐G.R.O.W 多重引擎成長策略，Q1面臨季節性調節以及產品結構轉型，在維持營運穩定的同時，積極儲備後續成長動能。
- **封測相關:** 先進封裝擴產趨勢明確，客戶端需求強勁。Q1 部分產品受限於原廠產能滿載，導致出貨遞延，遞延訂單將於 Q2 起陸續發酵。結合下半年新機備貨需求，營運將呈現逐季走揚的態勢。
- **散熱相關:** AI、HPC散熱需求強勁，均熱片Q1 營收有望在前一季的高基期下再創新高，且維持逐季成長態勢; 併購案持續進行中。
- **IC載板:** Q1高階載板需求維持強勁，主要客戶接單狀況良好，惟受原材料供應與產能限制影響，交期仍偏長，持續協調供應鏈以支援客戶需求。

Thanks

感謝各位投資大眾的參與

主 講 人：黃道景總經理

股票代號：3444

發 言 人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw
代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw
股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw

